



2020年3月期 決算説明資料

2020年5月14日



内外テック株式会社
JASDAQ3374



このたび、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によりお亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈りすると共に、罹患された皆様および感染拡大により様々な影響を受けている皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。

また、日夜最前線にて対応されている医療関係者の皆様に心から敬意と感謝の意を表します。



会社概要

半導体製造工程概要



5GやIoTなどの普及や拡大を背景にロジック、メモリーの需要拡大が見込まれ、前工程装置の設備投資の再拡大が期待される

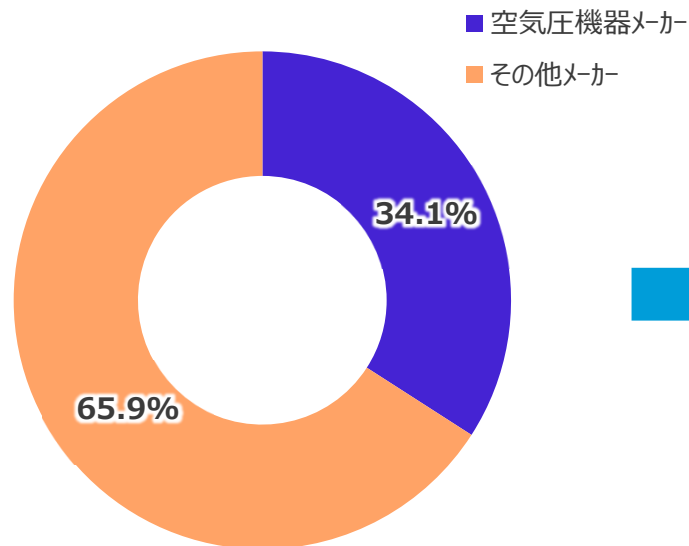
内外テック
技術提案商社

+

内外エレクトロニクス
受託製造メーカー

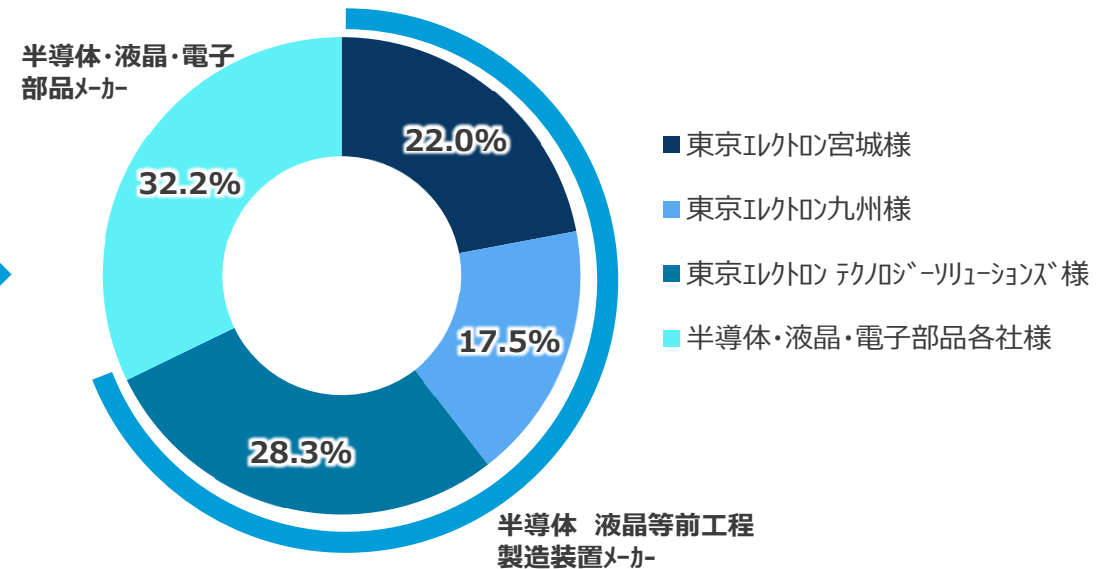
＝ モノづくりができるメーカー商社

【仕入先】



【販売先】

東京エレクトロン様グループで約7割



内外テック 仕入先・販売先

- 仕入先メーカー数 約1500社
 - 得意先数 約 960社
 - 主な取扱い商品サービス 空気圧機器、真空関連機器、機工部品、受託製造、保守メンテナンス、装置改造
- 年間取扱いアイテム 約62,000件



2020年3月期 実績

2020.3期 業績

- 売上高 23,825百万円 (前期比 8.2%減) ↓
- 営業利益 547百万円 (前期比 13.3%減) ↓

期初計画達成するも、2期連続の減収減益
⇒ロジック向け設備投資の回復が見られるも、減収減益
⇒利益面では、受託製造事業が大幅に改善

トピックス

- 中長期的な半導体市場の拡大に備え、熊本地区の拡充
⇒九州物流センター (2019年9月 土地建物取得)
⇒熊本サービスセンター (2019年9月 土地建物取得)
- 今後の受注増加に備え、新宮城物流センター増築棟の着工

2021.3期 業績予想

- 5Gなど新技術による半導体需要を背景に、スマートフォンやデータセンター向け需要増により成長を見込む
- ロジック向け投資の継続と、メモリー投資の回復を見込む
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるテレワークでIT機器の需要拡大

■ 期初予想を上回るも、2期連続減収減益

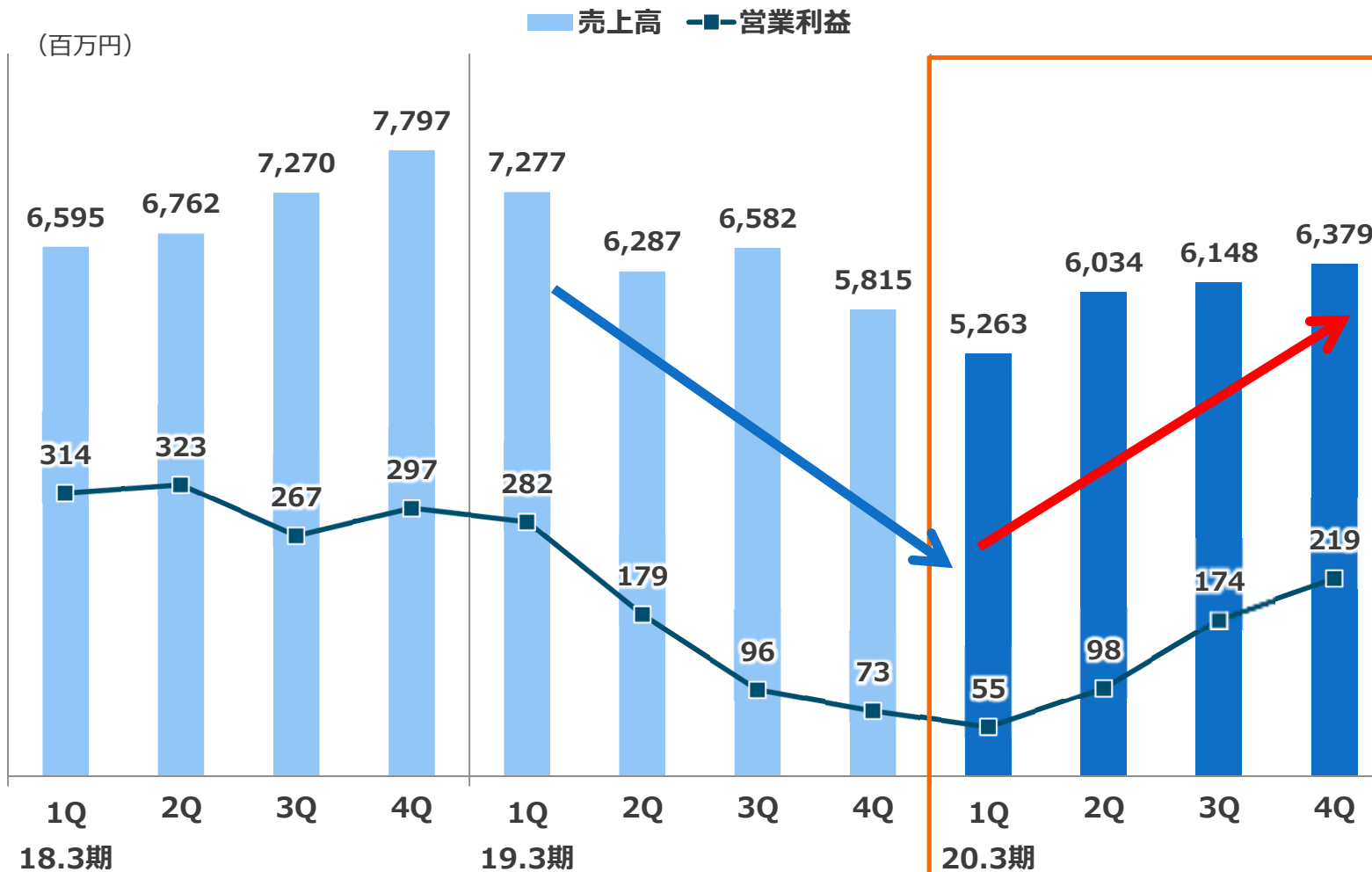
(百万円、%)

	2019.3期			2020.3期			
	実績	前期比	構成比	実績	前期比	構成比	期初予想
売上高	25,963	△ 8.7	100.0	23,825	△ 8.2	100.0	21,900
売上原価	23,146	△ 8.1	89.1	21,187	△ 8.5	88.9	-
販管費	2,184	+ 7.4	8.4	2,090	△ 4.3	8.8	-
営業利益	632	△47.4	2.4	547	△13.3	2.3	475
経常利益	621	△47.5	2.4	533	△14.1	2.2	443
親会社株主に帰属する 当期純利益	409	△52.2	1.6	333	△18.5	1.4	300

- 売上高は、メモリーの需給バランス調整などによる半導体市況の低迷が続くも、5GやPC向けロジック半導体の需要増加により期初予想を上回る
- 基幹システム構築に伴い減価償却費が増加するも、主に人件費を中心に販管費の抑制
- 各段階利益は、売上高の減少により減益になるも、期初予想を上回る
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響は限定的

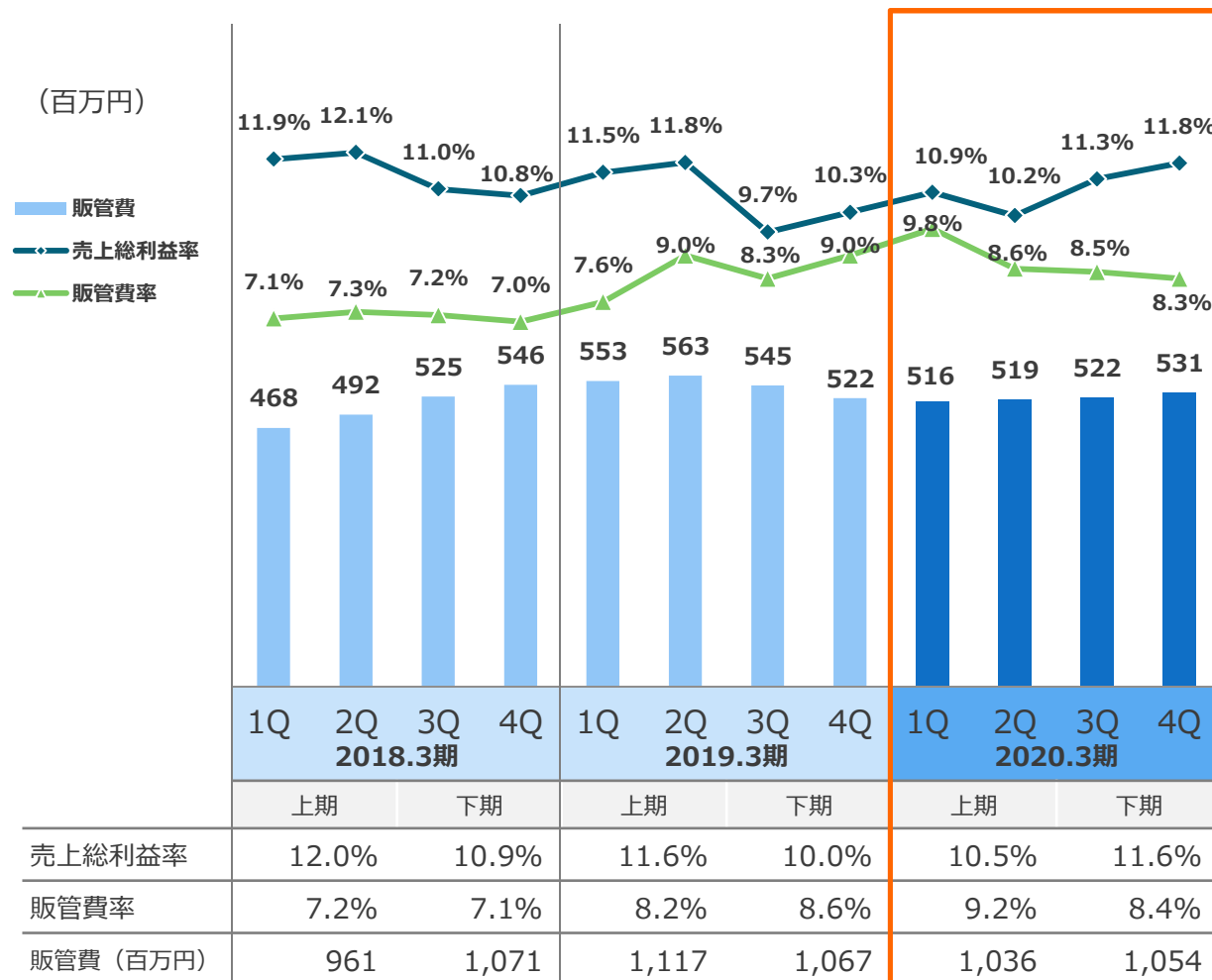
売上高・営業利益（四半期ベース）の推移

売上高は、ロジック向け設備投資需要により1Qをボトムに回復傾向
営業利益は、売上高回復により増加



売上総利益率・販管費（四半期ベース）の推移

売上総利益率は、前3Qをボトムに回復傾向 販管費は、一定水準で推移



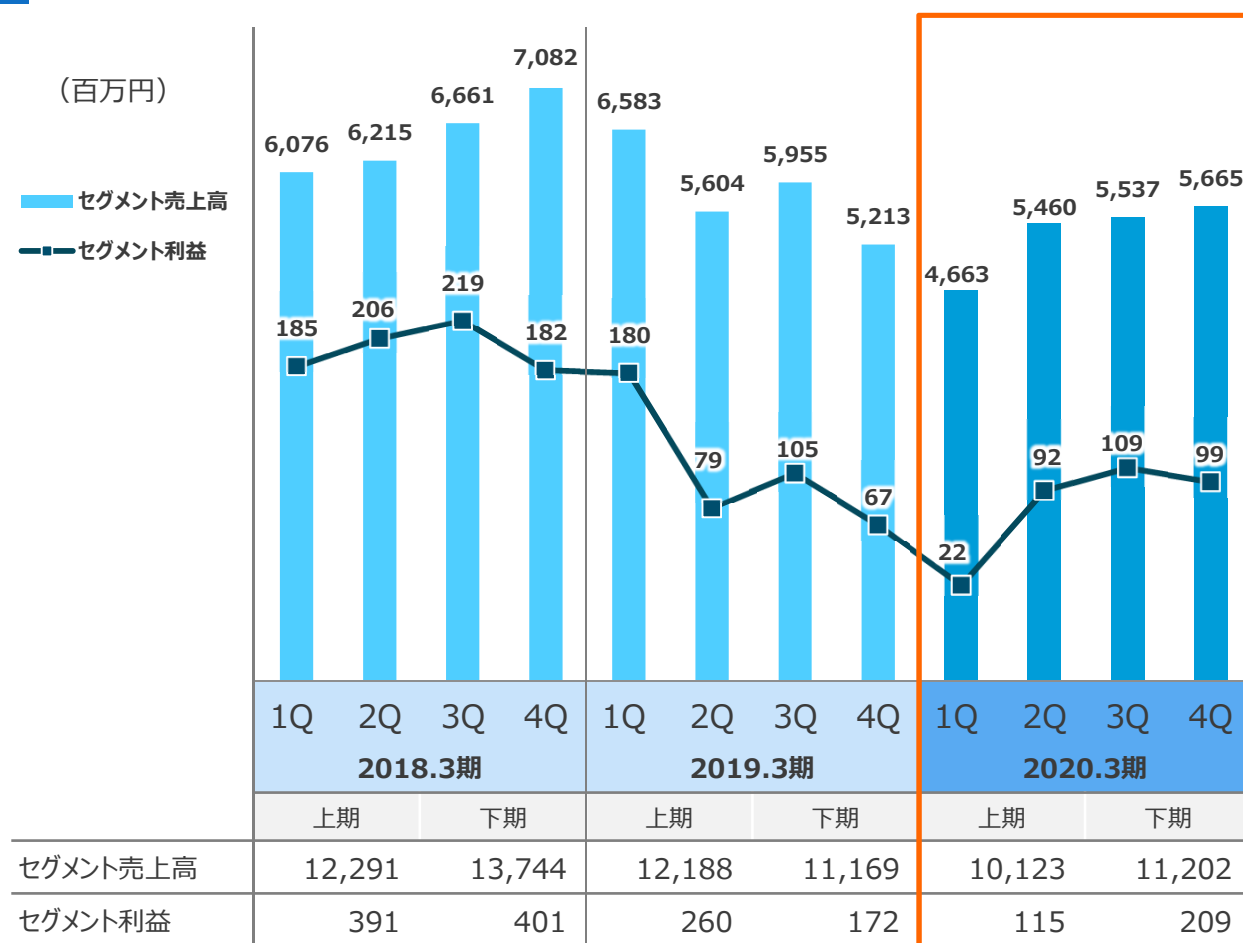
売上総利益率

- 前3Qをボトムに回復傾向
- 3Q以降、受託製造事業の操業度が改善したことにより、売上総利益率は大幅に改善

販管費

- 販管費抑制により、一定の範囲で平準化
- 増収傾向により販管費率は低下傾向

2期連続の減収減益 セグメント売上高・利益ともに期初計画を上回り、回復傾向



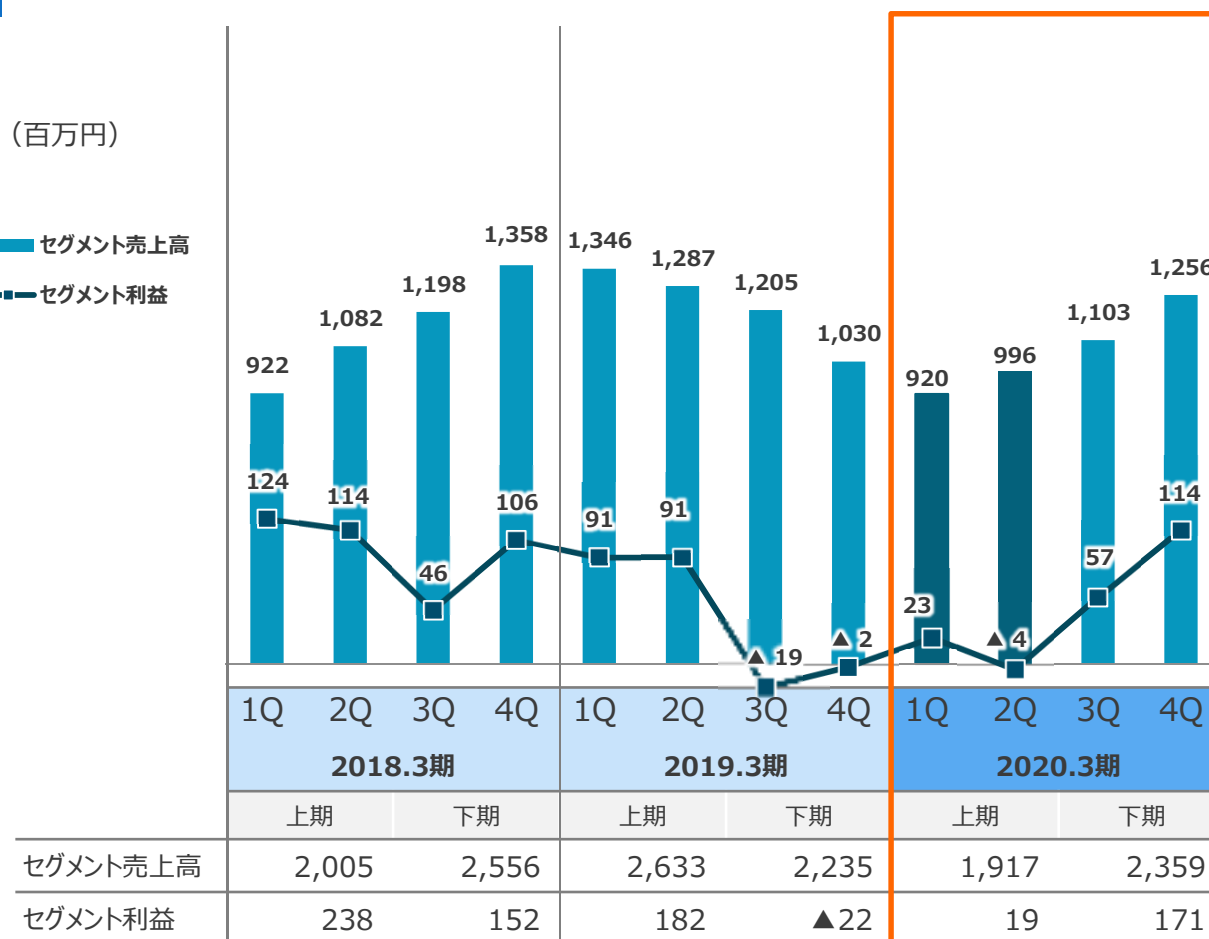
セグメント売上高 21,326百万円
(前期比 ▲8.7%)

- ロジック向けの投資姿勢が強まり、2Q以降回復が見られる

セグメント利益 324百万円
(前期比 ▲25.0%)

- 売上高減少に伴い、セグメント利益減少
- 基幹システム構築に伴い減価償却費が増加するも、物流の人件費を中心に出張費や支払手数料などの販管費を抑制
- 売上回復に伴い、2Q以降は前3Qの水準まで回復

減収ながら増益に セグメント売上高・利益ともにほぼ計画通り



セグメント売上高 4,276百万円
(前期比 ▲12.2%)

- 主要顧客の増産により回復傾向

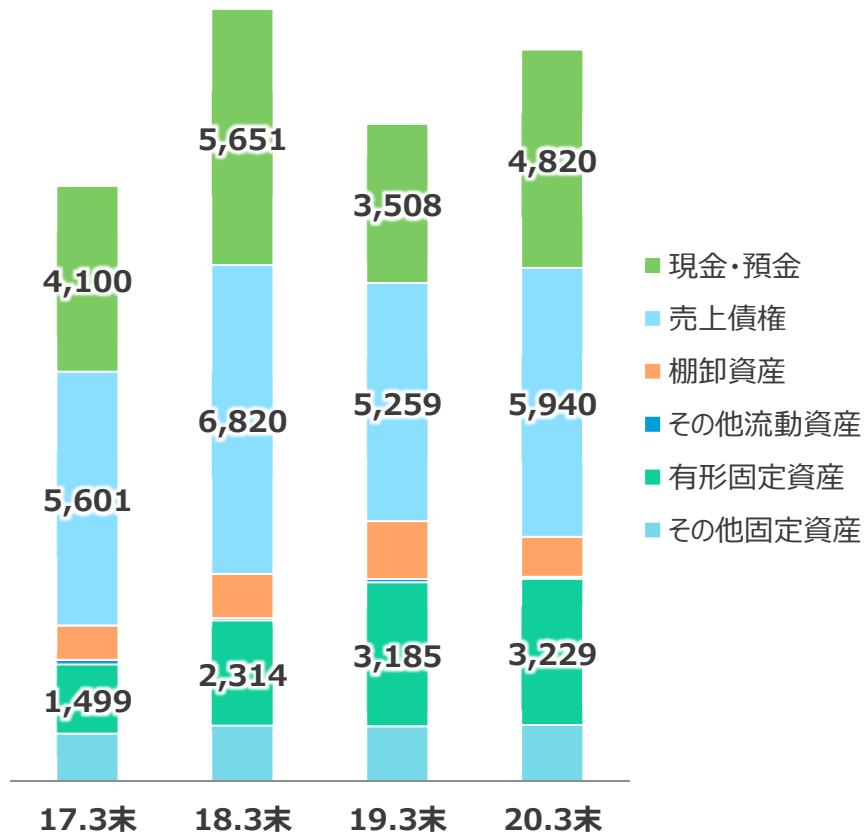
セグメント利益 190百万円
(前期比 +18.8%)

- 売上増加に伴い、労務費を中心とした固定費率の低下
- 外注加工費を中心とした変動費の抑制
- 3Q以降、損益分岐点操業度が改善し、大幅に利益拡大

貸借対照表

◆ 資産

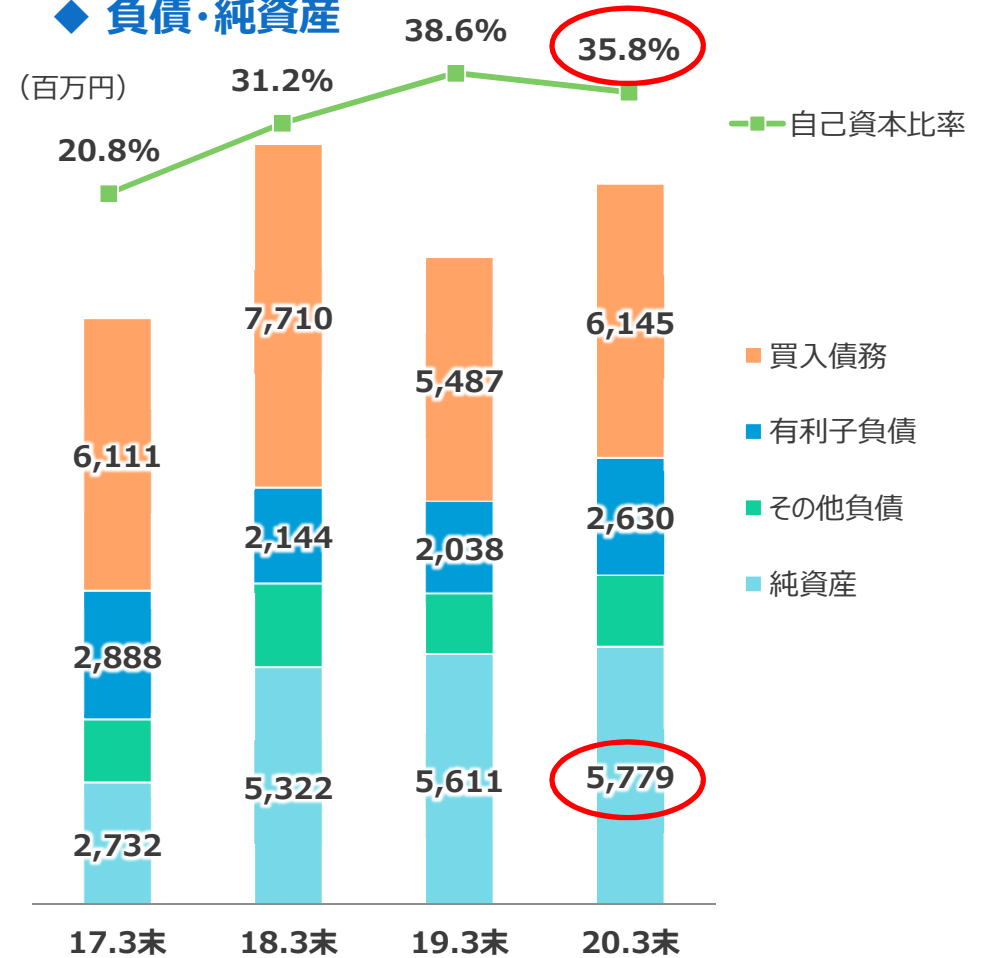
(百万円)



- 現金・預金は、借入増加により13億12百万円増加
- 売上高の上昇局面につき、売上債権が6億80百万円増加

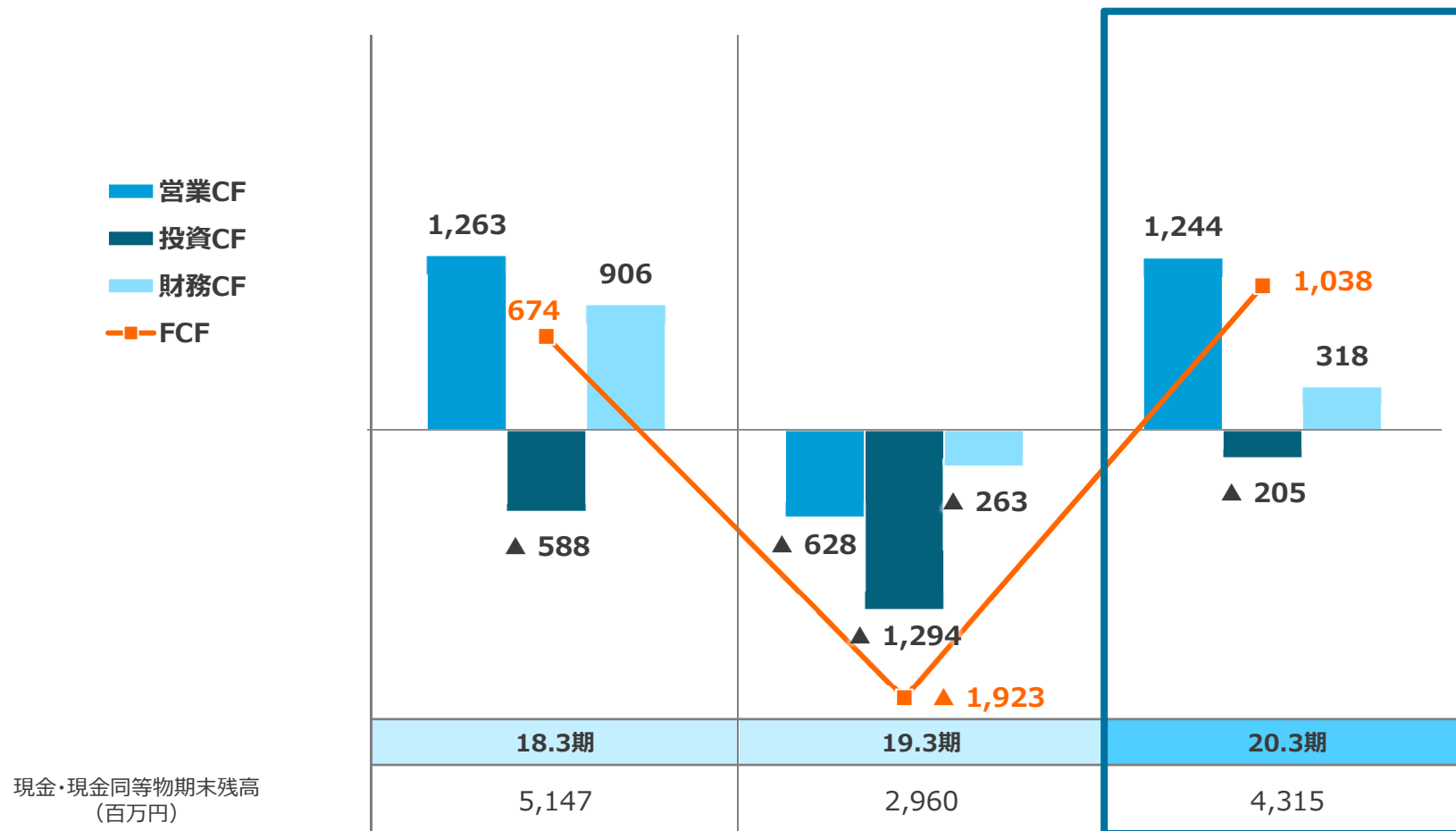
◆ 負債・純資産

(百万円)



- 運転資金確保のため有利子負債が5億92百万円増加し、自己資本比率は35.8%に低下
- 仕入高上昇に伴い、買入債務が6億57百万円増加

営業キャッシュフロー増と設備投資一巡でフリーキャッシュフローはプラスに



- 売上債権・仕入債務のバランス改善、棚卸資産の減少から、営業キャッシュフローは1,244百万円に拡大
- 将来に向けた設備投資は一巡したことにより大幅に減少し、投資キャッシュフローは▲205百万円に縮小



2021年3月期 予想

全てのステークホルダーの皆様の健康と安心を前提とした、事業の円滑な継続体制の構築

1月末にはBCP対策本部を設置し、様々な処置対応を実施

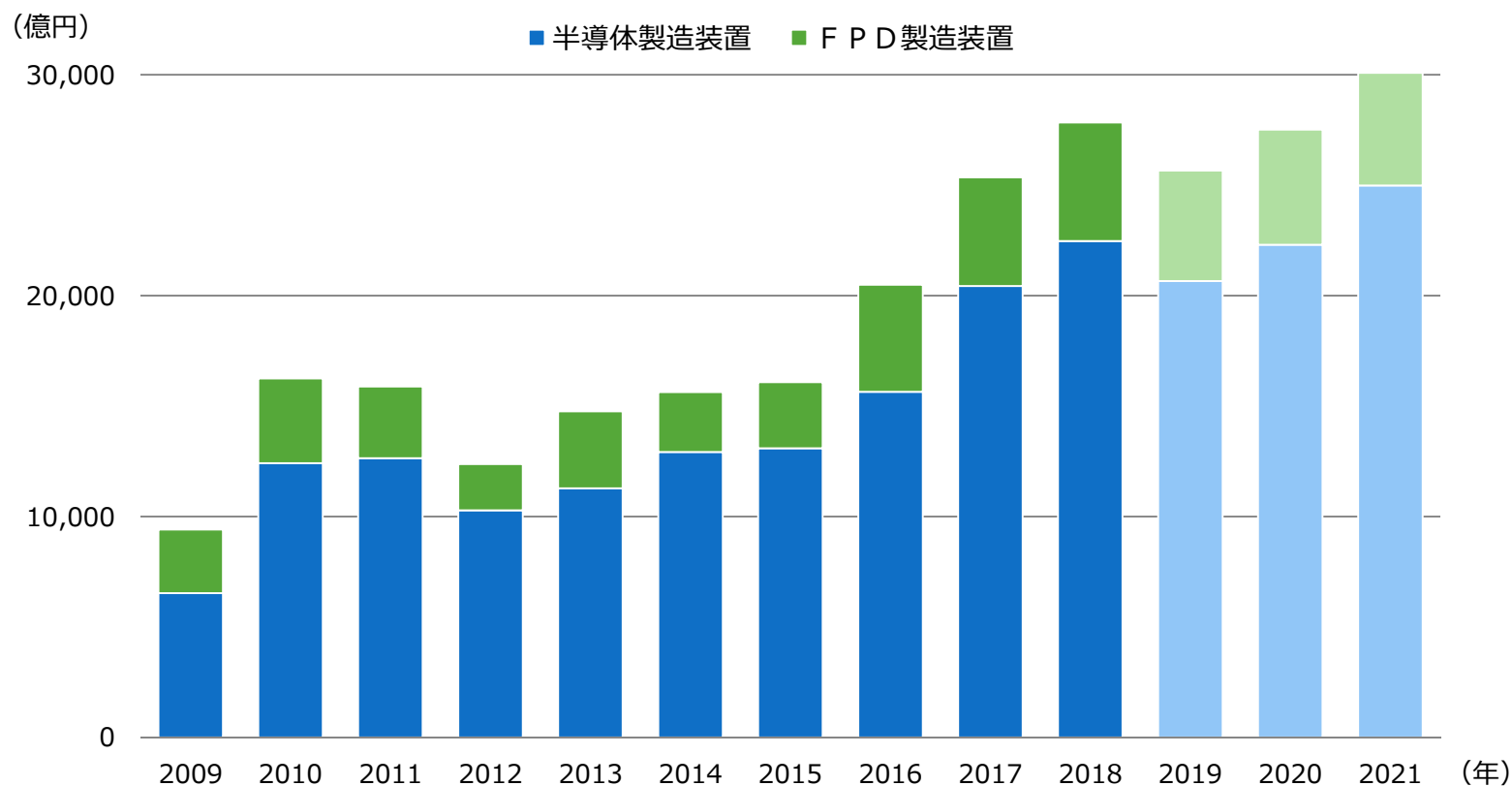
- 健康・安否確認システムを活用し、毎朝8時30分までに全従業員を対象に健康状態確認の管理体制を構築
- 感染リスク低減の観点から、在宅勤務によるテレワークや時差出勤および社有車での通勤を実施。特に、お取引先様との接触が多い営業部門と管理部門の在宅勤務率は80%以上
- 工場および物流センターは、厳重な感染予防対策と管理を実施し、通常稼働
- 毎日お取引先様とのコミュニケーションを図り、生産および納期遅延ゼロの活動を継続
- 今後の市場を考慮し、一年先を見据えた部材の確保

現在のところ事業運営に大きな支障なし

(2020年5月14日現在)

日本製半導体製造装置販売高は、2019年に減少するも、2020年以降再拡大を見込む

半導体・FPD装置 日本製装置販売高予想



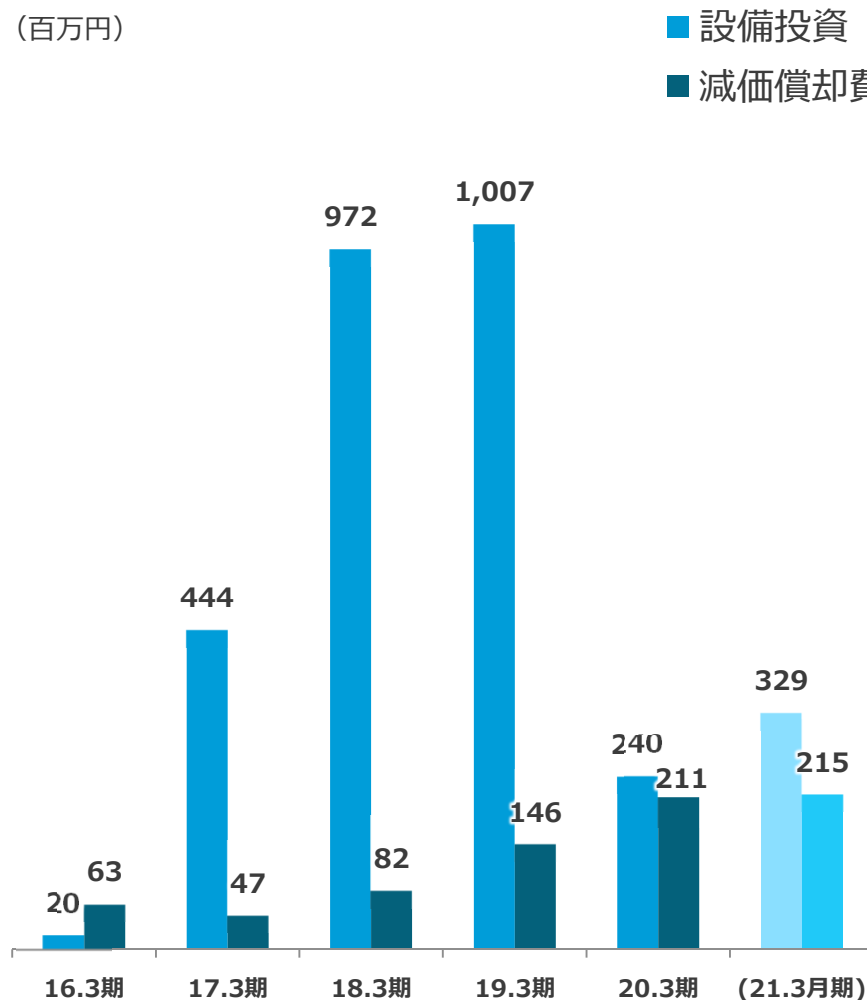
(SEAJ 2020年1月9日発表資料をもとに作成)

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるマクロ経済への影響を踏まえ、合理的に予想することが可能となった時点で速やかに開示予定

- 5G対応スマートフォンの普及やデータ通信量増加によるデータセンター向け需要の増加により、ロジック向け投資の継続とメモリー投資の回復が見込まれる。
- 半導体需要の増加に伴い、半導体製造装置需要も長期的な成長持続が見込まれる。

将来を見据えた受託製造の先行投資は、ほぼ一巡

(百万円)



主要設備投資

● 17/3期

- 内外エレクトロニクス 仙台事業所 第二工場新設 3.3億円

● 18/3期

- 内外エレクトロニクス 仙台事業所 クリーンルーム新設・拡張 6.3億円
- 内外テック 熊本県合志市 営業所・工場統合施設取得 1.5億円

● 19/3期

- 内外エレクトロニクス 岩手県奥州市 工場用地取得 0.5億円
- 内外エレクトロニクス 仙台事業所 第三工場新設 6.0億円
- 内外テック 熊本営業所 営業所・工場統合施設改修 1.8億円
- 内外エレクトロニクス 福島事業所 工場増改築 1.8億円

● 20/3期

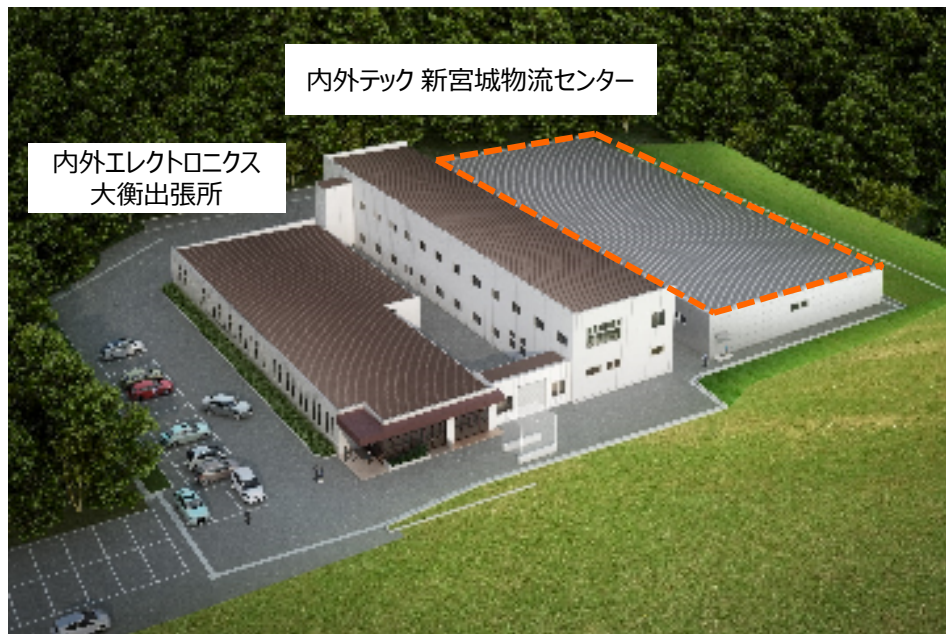
- 内外テック 熊本県合志市 メンテナンス施設・物流センター取得 1.3億円

● 21/3期予定

- 内外テック 新宮城物流センター 新棟増築 3.2億円

今後の受注量増加に備え、新物流センターを新設

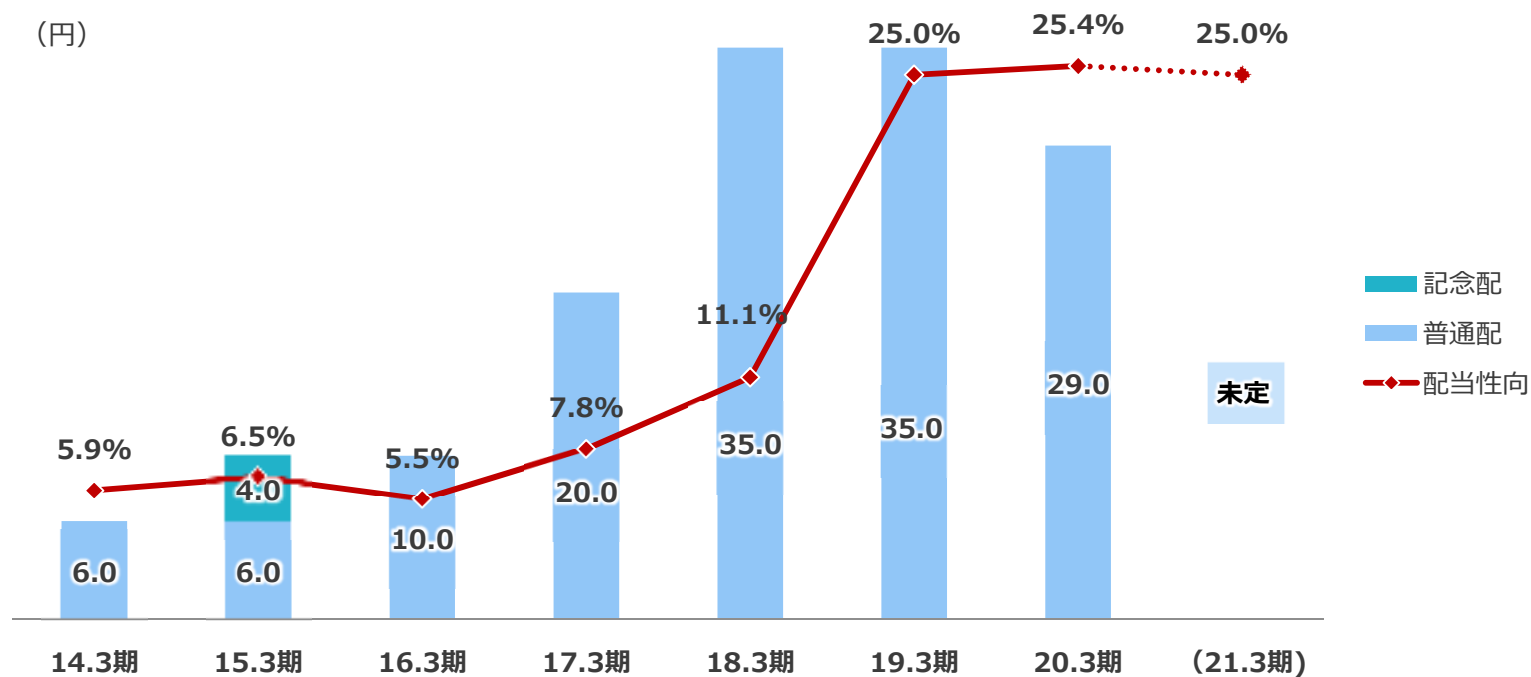
- 新宮城物流センター増築棟（延床面積 1,465㎡）は、2020年9月竣工予定
- 投資金額は、3.2億円程度の予定
- 5Gやデータセンター需要拡大に備えた物流戦略



(2020年5月11日現在の状況)

連結配当性向25%程度を基準

- 2020年3月期の配当金は、期初予想を上回る
- 2021年3月期の配当予想は、業績予想と同時に開示予定



(注) 配当金は、2016年10月1日付の株式併合2→1株を考慮して過去遡及した数値を記載。

本日はありがとうございました。

- 本資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
- 本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、その実現・達成を保証、約束するものではなく、また、その情報の正確性、完全性を保証、約束するものではありません。
- 銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

An aerial photograph of a city skyline, likely Tokyo, featuring numerous skyscrapers and a prominent red and white tower (Tokyo Tower) on the right side. The sky is a clear, light blue with some light clouds. The text is overlaid on the upper portion of the image.

『ものづくり』を支える

メカニカルソリューション

内外テック株式会社